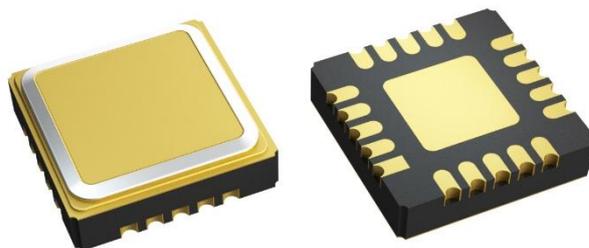


特点:

- 频率范围: 0.3~5.0GHz
- 插入损耗: 典型值1.5dB
- 隔离度: 典型值 45dB
- 开关时间: 典型值100ns
- 单刀双掷吸收式
- QFN 金属陶瓷封装
- 尺寸: 4.0×4.0×1.5mm

图片:

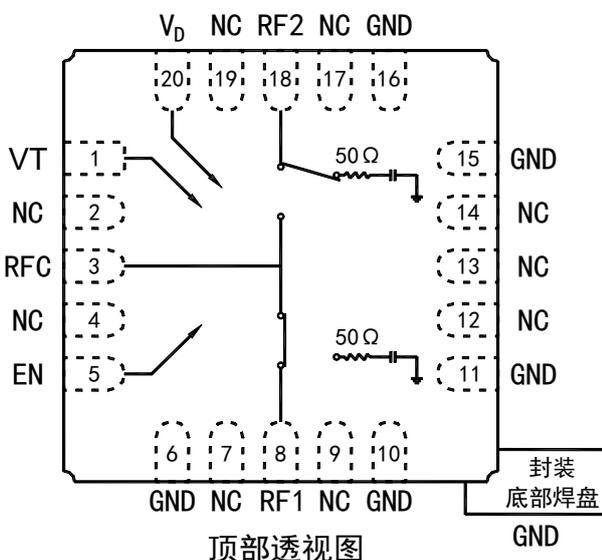


性能参数: (50Ω系统, T_A=-55~+85℃)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	V _D =+5.00V f= 0.3~5.0GHz P _{IN} =0dBm 控制电平: 0 /+5.0 V	0.3		5.0	GHz	
插入损耗	IL			1.5	2.5	dB	
端口驻波比	VSWR			1.4:1	1.8:1		
隔离度	ISO		40	45		dB	
输入-1dB 压缩点	IP-1dB		+20	+25		dBm	
开关时间 ^①	t			100	110	ns	
上升沿	t _{RISE}			50	55	ns	10% RF~90% RF
下降沿	t _{FALL}			30	35	ns	90% RF~10% RF
控制电平	V _{TH}		+3.3	+5.0	+5.0	V	EN、VT 端口
	V _{TL}		0		+0.5	V	
电源电压	V _D	+4.75	+5.00	+5.25	V		
工作电流	I _D		3	4	mA		
质量	m			1	g		

注: ①开关时间: 开通时间=50% Ctrl~90% RF, 关闭时间=50% Ctrl~10% RF。

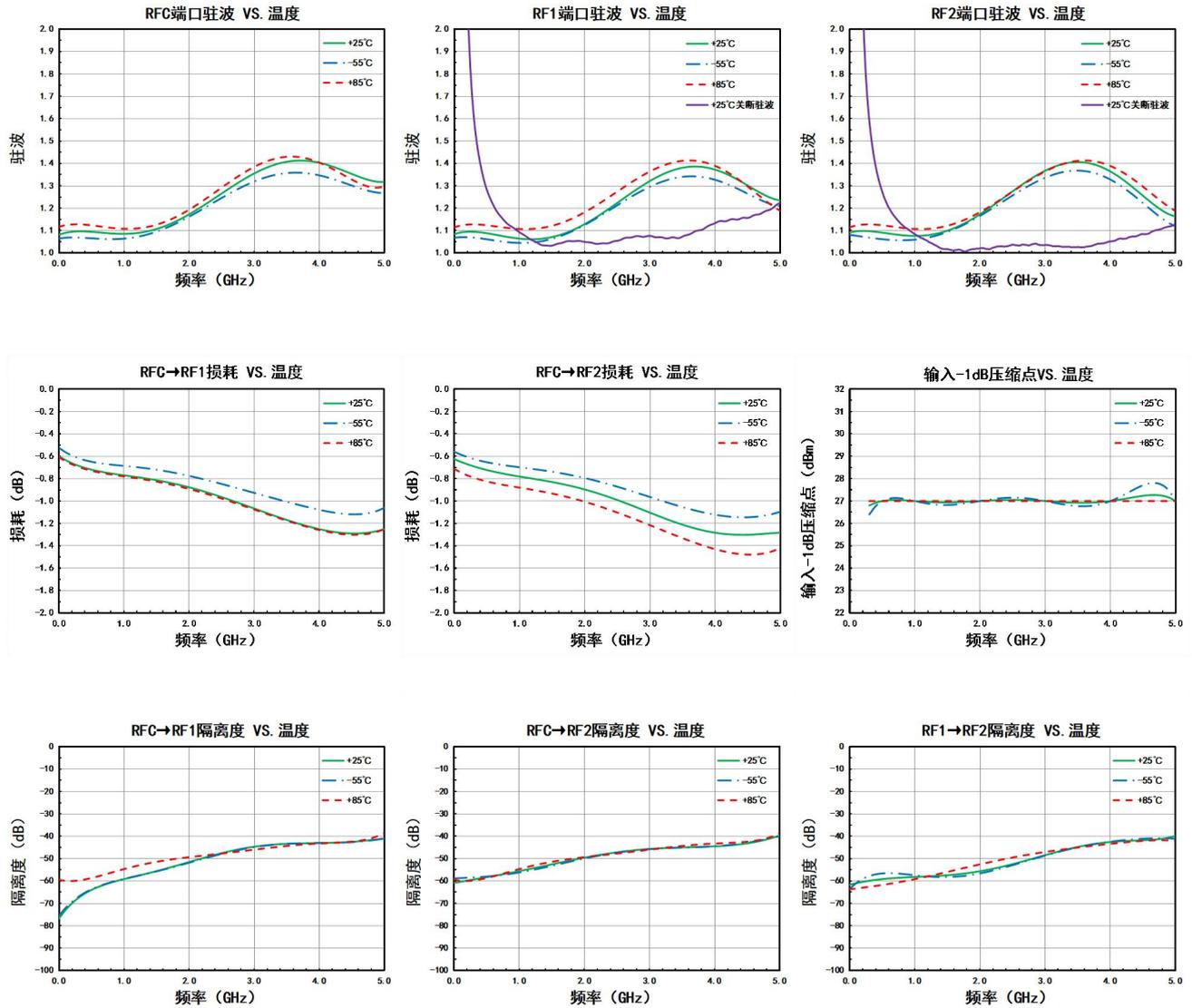
功能框图:



引脚定义:

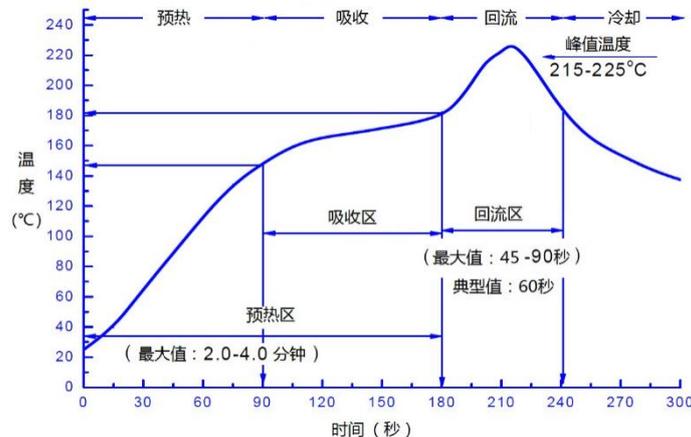
引脚编号	符号	描述
3	RFC	射频输入端口, DC 耦合
8	RF1	射频输出端口 1, DC 耦合
18	RF2	射频输出端口 2, DC 耦合
20	V _d	电源端口, +5.00V
1	VT	控制端口, 0 /+5.0 V
5	EN	使能端口, 0 /+5.0 V
2/4/7/9/12/13/14/ 17/19	NC	悬空, 建议接地
6/10/11/15/16	GND	接地
底部中央焊盘	GND	接地

典型测试曲线：(50Ω系统, $V_D=+5.00V$, $V_T=0/+5.0 V$, $P_{IN}=0dBm$)



产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护。
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）。
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点+183°C回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流焊设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过极限参数中装配温度。

4. 如特殊情况需采用手工补焊，烙铁温度+350°C，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度+10~+35°C，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。